

# スマートプロセス学会誌

目次 Vol. 13 No. 6 2024 (令和6年11月)

接合部の組織・界面・形態制御が拓くエレクトロニクスの進化

会告	.....	N22
巻頭言	接合部の組織・界面・形態制御が拓くエレクトロニクスの進化 異 裕章.....	271
特集		
解説	毛管現象を利用した液相浸透ダイアタッチ技術 福本信次.....	272
	Sn-Bi 合金の超塑性変形挙動とメカニズム 山内 啓.....	278
	カーボンニュートラルの推進に貢献する Ag 焼結材料・接合技術 平塚大祐.....	285
	チップオンウエハ実装の進化を支える要素技術 櫻井大輔・糸井清一・生田敬子.....	293
研究論文	Cu-Ni 合金めっき液を用いた電気めっきと脱合金化によって形成された 三次元構造膜の接着性評価 小林竜也・Pham Thai Anh・荘司郁夫.....	301
会報・掲示板	.....	N26

**Journal of Smart Processing**  
*Vol. 13 No. 6* 2024 (November 2024)

CONTENTS

Advancing Electronic Devices by Control of Joints' Microstructure, Interfaces and Morphologies

**S.P.S. Announcement** ..... N22

**Preface of Feature Article**

Advancing Electronic Devices by Control of Joints' Microstructure, Interfaces and Morphologies  
Hiroaki TATSUMI.....271

**Feature Articles**

**Review Articles**

Transient Liquid Phase Infiltration Die-Attach Based on Capillary Action  
Shinji FUKUMOTO.....272

Superplastic Deformation Behavior of Sn-Bi Alloys and Its Mechanism  
Akira YAMAUCHI.....278

Ag Sintered Materials and Bonding Technology Contributing to Promotion of Carbon Neutrality  
Daisuke HIRATSUKA.....285

Core Technologies to Support Evolution of Chip on Wafer Bonding  
Daisuke SAKURAI, Kiyokazu ITOI and Keiko IKUTA.....293

**Regular Research Article**

Evaluation of Adhesion on Three-Dimensional Structured Film Formed by Plating and Dealloying with Cu-Ni Alloy Plating Solution  
Tatsuya KOBAYASHI, Thai Anh PHAM and Ikuo SHOHJI.....301

**S.P.S. News** ..... N26